

光トランシーバの最新動向と各種実装形態の展望

セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/2509104>

1名分料金で
2人目無料

- ◆日時: 2025年09月24日(水) 09:30~12:30
 ◆【アーカイブ配信: 9/25(木)~10/2(木) (何度でも受講可能)】の視聴を希望される方は、
 ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/2509104> こちらからお申し込み下さい。
 ◆受講料: 1名につき49,500円(税込、資料付)

会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円(税込)から

・1名で申込の場合、**46,200円(税込)**へ割引になります。

・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、**計49,500円(2人目無料)**です

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師: (株)日立製作所 研究開発グループ エッジコンピューティング研究部

研究員 博士(工学)高武 直弘 氏 <ご専門> 光・電気実装、光結合、高周波電磁界解析

【講演の趣旨】

データセンタのトラフィックの急増に対応するため、光トランシーバの重要性が増しています。さらなる高速・大容量化に対応するには、データ伝送速度の高速化だけでなく、光トランシーバの小型化・高密度化も重要になっています。特に近年は、Co-Packaged Opticsと呼ばれるスイッチIC近傍に配置可能な小型光トランシーバの研究開発が注目を浴びています。

本セミナーでは、データセンタ内の高速データ伝送の現状および課題、超小型光トランシーバの構成と変遷について説明します。また、Co-Packaged Opticsに必要とされる高密度電気・光実装技術、特に高密度電気実装技術とGI型円形ポリマー光導波路を用いた小型・高効率な光結合技術を紹介し、これにより、小型・高密度光トランシーバの研究開発に必要な知識を養うことができ、若手・中堅の研究者・エンジニアの方の一助になることでしょう。

【プログラム】

- はじめに
 - データセンタ内の高速データ伝送と光インターコネクトの必要性
 - 光インターコネクト向け光トランシーバの適用形態の変化
 - Co-Packaged Opticsと高密度電気・光実装に対する要求
 - 小型光トランシーバの設計ポイントと従来技術の課題
- 狭幅絶縁層を有するグランド電極構造による高密度・低クロストーク実装技術
 - 高密度実装時のクロストーク発生要因と狭幅絶縁層を有するグランド電極構造
 - 等価回路モデルとクロストーク解析
 - 提案構造の放熱特性への影響
 - 光トランシーバの試作と光リンク特性評価
- 90°曲げGI型ポリマー導波路を用いた小型・高効率光結合技術
 - ポリマー導波路を用いた光結合の重要性とMosquito法
 - 90°曲げGI型導波路の構造最適化
 - ポリマー導波路の試作と挿入損失測定
 - 光リンク特性評価
- おわりに

『光トランシーバ【WEBセミナー】』セミナー申込書※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒< ☐LIVE / ☐アーカイブ >

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

☐Eメール ☐郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>